



# 2012年3月期 決算説明会

2012年5月24日

 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>



# Contents

## 1. ご挨拶、決算のポイント

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

## 2. 2012年3月期連結決算の概要

..... 管理本部 経理部長 古橋 博

## 3. 2013年3月期連結事業計画

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

## 4. 新たな成長に向かって

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

## 5. 質疑応答



# 1. ご挨拶、決算のポイント

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

# 1 決算のポイント



- フラットパネル関連の期ずれにより減益になりました。
- グループ総合力が強化されました。
- 受注が堅調に推移しました。



## 2. 2012年3月期連結決算の概要

..... 管理本部 経理部長 古橋 博

# 2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	11,498	12,378	879	7.7%
営業利益 (営業利益率)	699 (6.1%)	181 (1.5%)	▲517	▲74.0%
経常利益	726	150	▲576	▲79.3%
当期純利益	395	343	▲52	▲13.4%
1株当たり 当期純利益(円)	42.59	37.77	▲4.82	▲11.3%

研究開発費	262	361	99	38.0%
設備投資額	157	159	1	1.1%
減価償却実施額	250	281	30	12.4%

## 2-2 事業別売上金額



(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	2,611	2,777	166	6.4%
フラットパネル関連	4,330	3,512	▲818	▲18.9%
半導体関連	1,257	682	▲575	45.7%
太陽電池関連	2,004	1,140	▲864	43.1%
FEL関連	9	12	3	33.3%
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	—	3,049	3,049	—
クリーニング関連	1,287	1,206	▲81	▲6.3%
合計	11,498	12,378	879	7.7%

## 2-3 事業別受注金額



(単位:百万円)

	2011年3月期	2012年3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	2,776	3,623	847	▲30.5%
フラットパネル関連	4,913	7,975	3,062	62.3%
半導体関連	1,021	557	▲464	▲45.4%
太陽電池関連	1,965	911	▲1,054	▲53.6%
FEL関連	9	12	3	33.3%
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	—	2,222	2,222	—
クリーニング関連	1,287	1,206	▲81	▲6.3%
合計	11,971	16,506	4,534	37.9%

\* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注=売上となります。



## 2-4 事業別受注残高



(単位:百万円)

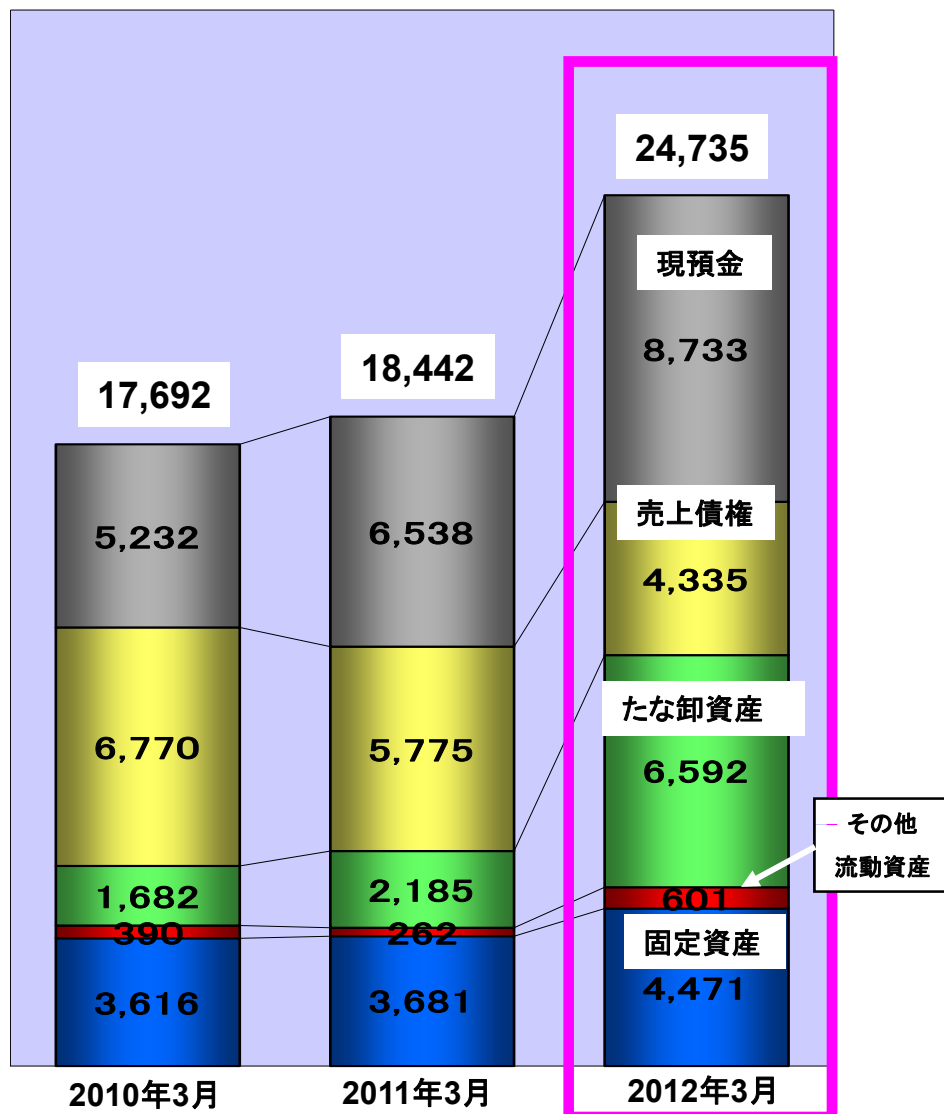
	2011年 3月期	2012年 3月期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	440	1,286	846	192.3%
フラットパネル関連	1,761	6,224	4,463	253.4%
半導体関連	139	15	▲124	▲89.2%
太陽電池関連	707	477	▲230	▲32.5%
FEL関連	0	0	0	—
精密熱処理関連 (ワイエイシイデンコー)	—	1,053	1,053	—
クリーニング関連	0	0	0	—
合計	3,047	9,055	6,008	197.1%

# 2-5 貸借対照表のレビュー



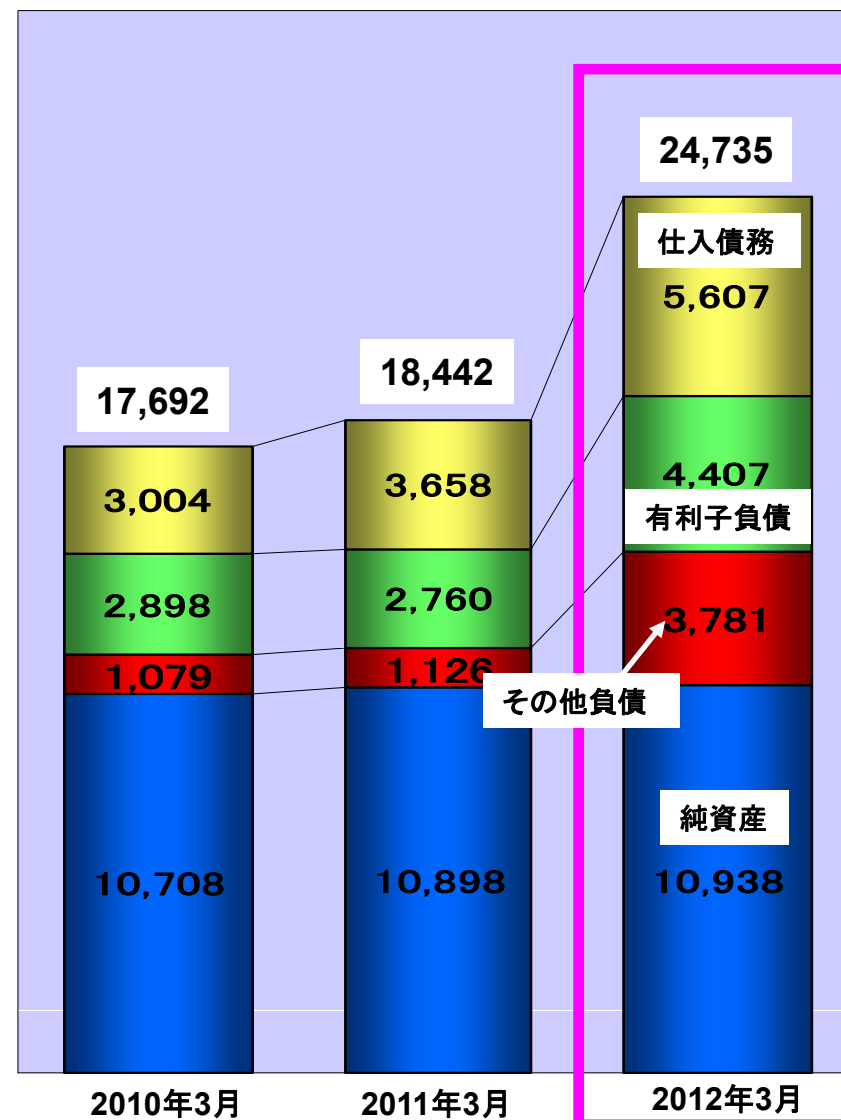
## 資産

(単位:百万円)



## 負債・純資産

(単位:百万円)



## 2-6 キャッシュフローのレビュー



(単位:百万円)

	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期
営業活動によるCF	330	1,854	1,760
投資活動によるCF	▲454	▲222	245
財務活動によるCF	11	▲295	131
現金及び現金同等物の期末残高	5,216	6,520	8,637



### **3. 2013年3月期連結事業計画**

**…………… 代表取締役 社長 百瀬 武文**

## ★ 事業環境と重点施策

### 《ハードディスク関連》

- クラウド用データセンターの増加に伴い、  
サーバー用ハードディスク需要が拡大
- バニッシャー装置、UVキュア装置のシェア100%
- クリーンコンベアの新規市場への展開

### 《フラットパネル関連》

- スマートフォン、タブレット、有機EL市場の拡大
- 高密度ドライエッチング装置、アニール装置のシェアアップ

## 《半導体関連》

- スマートフォン・タブレット、自動車向けに増加傾向
- テストハウス市場への横展開
- パワー半導体市場への深耕

## 《太陽電池関連》

- 売電価格の高値決定による設備投資の助長
- 高効率セルのニーズ増加
- 新プロセス装置の販売、ミニターンキーの販売

# 3-1 2013年3月期事業活動の指針



## 《FEL関連》

- 事業化のメド

## 《精密熱処理関連》

- 自動車部品市場の急拡大
- ハイテク業界への用途拡大

## 《クリーニング関連》

- 製販のグローバル化

# 3-1 2013年3月期事業活動の指針



## ★ 2013年3月期のキーワード

- 開発強化
- グループ総合力による製・販グローバル化
- 利益体質の強化



# 3-2 2013年3月期事業計画



(単位:百万円)

	2010年 3月期 (実績)	2011年 3月期 (実績)	2012年 3月期 (実績)	2013年 3月期 (見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
				上期	通期		
売上高	9,144	11,498	12,378	10,000	19,000	6,622	53.5%
営業利益	158	699	181	600	1,500	1,319	728.7%
経常利益	104	726	150	570	1,450	1,300	866.7%
当期純利益	11	395	343	300	800	457	133.2%
1株当たり 当期純利益(円)	1.27	42.59	37.77	33.63	89.69	51.92	137.5%

# 3-3 事業別売上計画



(単位:百万円)

	2010年 3月期 (実績)	2011年 3月期 (実績)	2012年 3月期 (実績)	2013年3月期(見込)		前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
				上期	通期		
メモリーディスク関連	1,062	2,611	2,777	1,900	4,500	1,723	62.0%
フラットパネル関連	6,135	4,330	3,512	6,000	7,600	4,088	116.4%
半導体関連	475	1,257	682	200	700	18	2.6%
太陽電池関連	203	2,004	1,140	500	1,900	760	66.7%
FEL関連	3	9	12	0	0	▲12	—
精密熱処理関連 (デンコー)	—	—	3,049	900	3,000	▲49	▲1.6%
クリーニング関連	1,266	1,287	1,206	500	1,300	94	7.8%
売上合計	9,144	11,498	12,378	10,000	19,000	6,622	53.5%

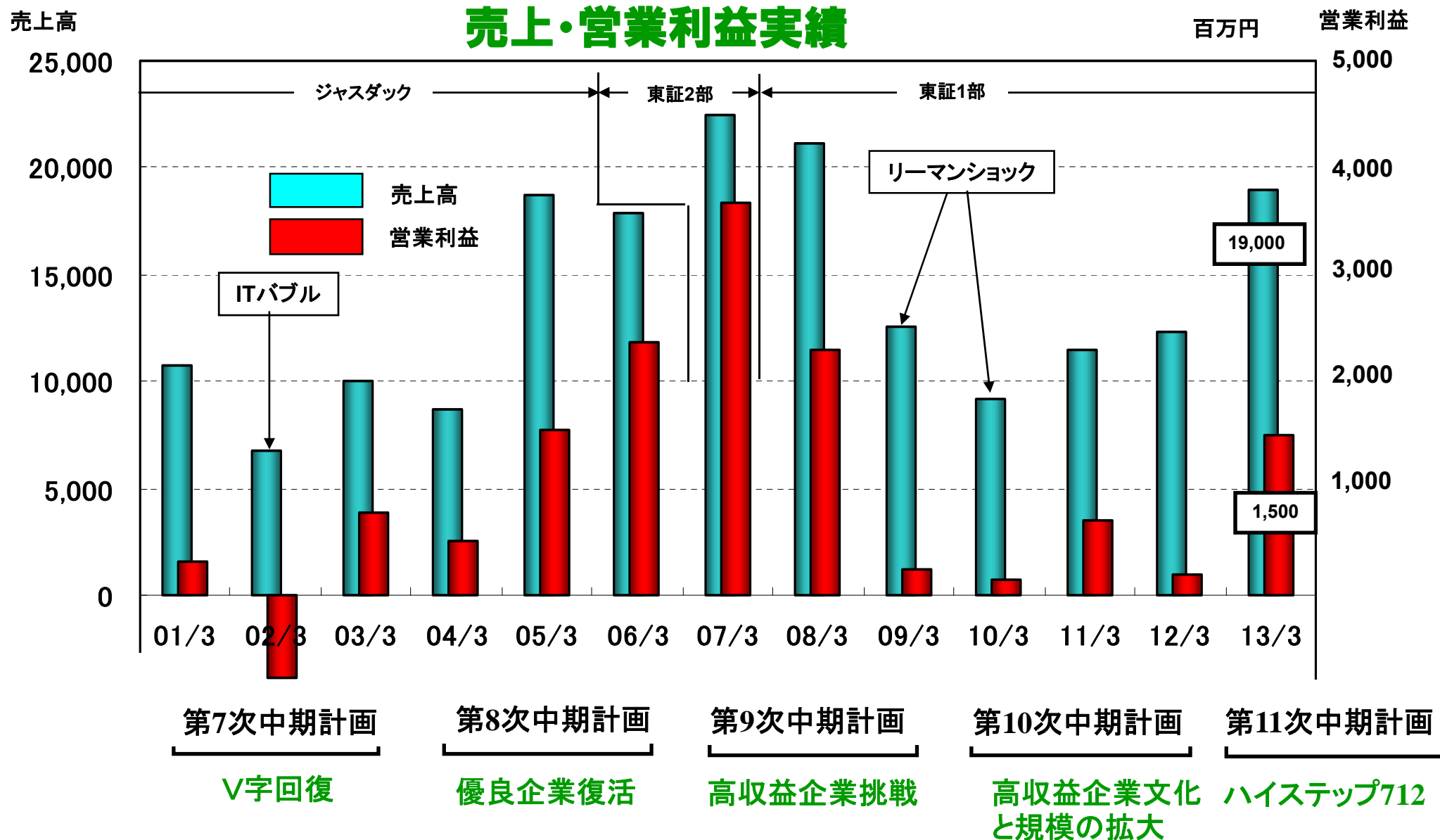
# 3-4 創業以来5年ごとの業績



(単位:百万円)

創業	年度	売上	営業利益
1年目	1974.5	43	1
5年目	1978.5	220	12
10年目	1983.5	725	49
15年目	1988.5	1,692	101
20年目	1993.5	4,467	369
25年目	1998.3	7,508	645
30年目	2003.3	10,055	766
35年目	2008.3	21,198	2,295

# 3-5 事業別連結売上金額





## 4. 新たな成長に向かって

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

# 4-1 1,000億企業への挑戦



(単位:億円)

	第11次中期計画			第12次中期計画	
	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
既存製品 グループ	171				400
太陽電池	19				300
FEL	—				50
新規事業 M&A					250
合計	190	5カ年計画策定			1,000

# 4-2 達成への基本戦略(シナリオ)



## 〈1〉既存事業領域の拡大

(ハードディスク、フラットパネル、半導体、精密熱処理:ワイエシイデンコー、クリーニング)

- ①シェアアップ
- ②取扱製品の増加
- ③消耗品・サービス事業の拡大
- ④製販のグローバル展開の拡大

## 〈2〉太陽電池事業の拡大

- ①ターンキー販売
- ②製販のグローバル展開
- ③デバイス事業の取り込み

## 〈3〉新規事業領域への進出

- ①FEL事業
- ②成長産業への進出 (LED・パワー半導体・電池関連)
- ③M&A、アライアンス

## 〈4〉高収益企業文化の推進

## 〈5〉人材育成、コンプライアンス



# 添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品



# 1 基本情報



商 号	ワイエイシイ株式会社
証 券 コ ー ド	6298 (東証 1 部)
設 立	1973年 (昭和48年)年5月
代 表 者	代表取締役社長 百瀬武文
事 業 所 等	本 社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、新竹 (台湾) 工 場：昭島、山梨、熊本、大分
グ ル ー プ 会 社	ワイエイシイ新潟精機株式会社 (新潟県妙高市) HYAC Corporation (米国カリフォルニア州) YAC Systems Singapore Pte Ltd (シンガポール) YAC KOREA CO.,LTD (韓国城南市) 瓦愛新 (上海) 国際貿易有限公司 (中国上海市) 株式会社ワイエイシイデンコー (東京都青梅市)
投 資 会 社	株式会社 NDマテリアル
資 本 金	2,756百万円
事 業 内 容	エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の 開発・設計・製造・販売
決 算	3月31日

## 2 **ワイエイシイの特徴**

---

- (1) 7分野の事業領域**
- (2) ファブレス**
- (3) M&A、アライアンス**
- (4) 製・販のグローバル企業（アジアに注力）**
- (5) デバイス事業への参入**
- (6) 社員の経営参画（大討論会）**
- (7) 依命システム**

# 3 グローバルネットワーク

## Global Network

### 海外展開

積極的な海外展開により、より競争力のあるグローバル企業グループを目指します。

社会構造の変化に伴い、企業の成長を維持するためには、海外での事業展開が不可欠な時代になってきております。ワイエイシイにおいては、既存の米国カリフォルニア、シンガポールに加え、2007年より、台湾、韓国、中国上海の営業拠点を相次いで設立し、アジア地区を中心とした積極的なグローバル展開を推進してまいりました。今後はこれらの拠点を通じた現地生産、現地調

達、さらには海外企業に対するM&Aについても積極的に取り組むことにより、アジア地域を中心とした営業基盤を拡大してまいります。そしてワイエイシイグループとして、よりコストパフォーマンスの高い高品質の製品を供給できる様、環境整備を進めてまいります。



●**瓦爰新(上海)国際貿易有限公司**  
中国市場における各種製品の販売・メンテナンス拠点  
(中国上海市)



●**YAC Systems Singapore Pte Ltd**  
アジアにおける各種装置の製造・販売・メンテナンス・資材調達拠点  
(シンガポール)



●**HYAC Corporation**  
北米ハイテク企業向け各種装置の販売・メンテナンス拠点  
(米国カリフォルニア州)

●**Y.A.C. Korea Co.,Ltd**  
韓国内における液晶製造装置、太陽電池製造装置の販売・メンテナンス拠点  
(韓国城南市)



●**YAC 台湾支店**  
台湾市場における各種製品の販売・メンテナンス拠点  
(台湾台北市)

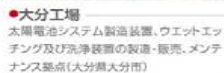
●支店  
●子会社(海外)



●**ワイエイシイ新海精機株式会社**  
クリーニング用各種上機、自動包装機のR&D・製造拠点(新潟県妙高市)



●**大阪営業所**  
関西地域における販売・メンテナンス拠点(大阪府大阪市)



●**大分工場**  
太陽電池システム製造装置、ウェットエッチング及び洗浄装置の製造・販売・メンテナンス拠点(大分県大分市)



●**熊本製作所**  
ロジックハンドラーのR&D・製造・販売・メンテナンス拠点(熊本県菊池郡)



●**テクニカルセンター**  
製品・生産技術開発の中核拠点  
(東京都昭島市)

●**株式会社デンコー**  
FPD用熱処理装置、電子部品用加熱装置、太陽電池用熱処理装置、遠赤外線ヒーター及び応用機器の設計・製造・販売  
(東京都青橋市)



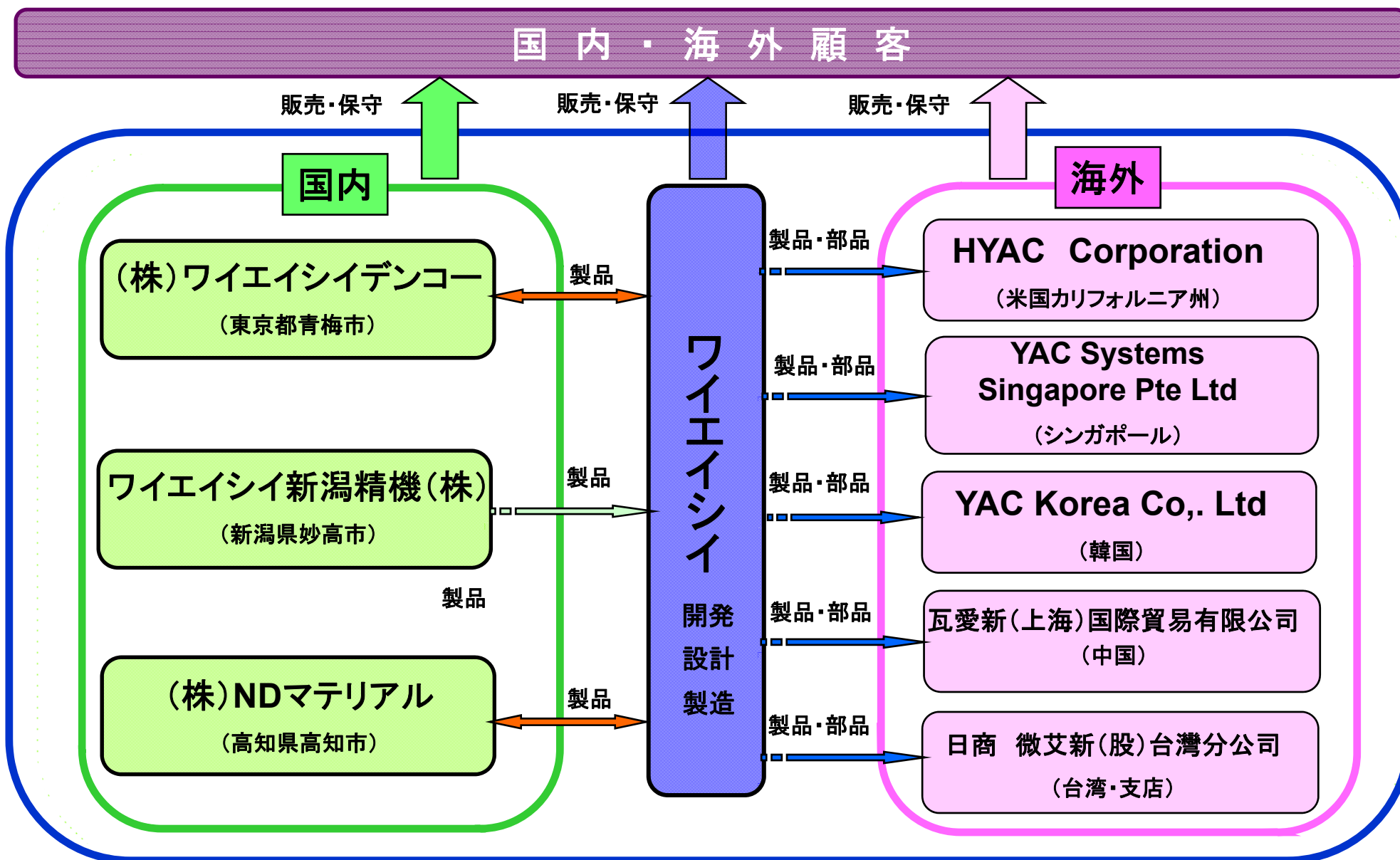
●**本社・本社工場**  
グループ全体のヘッドクォーター各事業所の中核拠点(東京都昭島市)



●**山梨工場**  
半導体・液晶向けプラズマエッチング・アッシング装置のR&D拠点  
(山梨県南アルプス市)

●本社  
●R&D・製造拠点  
●販売・メンテナンス拠点  
●子会社(国内)

# 4 ワイエイシイグループの構成



# 5-1 メモリーディスク事業製品



<b>バニッシャー</b>	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
<b>ワイピング</b>	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
<b>UVキュア装置</b>	基盤上の磁性膜面に潤滑剤(紫外線(UV)の波長に適合した潤滑剤が完成)を薄くなじませる装置
<b>クリーンコンベア (HD工場向け)</b>	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
<b>クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)</b>	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。
<b>クリーンコンベア (液晶工場向け)</b>	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア

## 5-2 フラットパネル事業製品



### プラズマドライエッチング装置

液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。

### アニール装置

膜質の改質、改善をおこなうための熱処理装置。



高密度プラズマドライエッチング装置



新製品

G5.5高密度プラズマドライエッチング装置の  
プロセスチャンバーユニット



アニール装置 (RTAタイプ)

## 5-3 半導体事業製品

### ロジック系IC用 ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程でテスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づきICを良品と不良品に自動選別する装置。  
必要に応じて精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)



ICテストハンドラー(16個同時測定・常・高温タイプ)

## 5-4 太陽電池事業製品

### 太陽電池(結晶・多結晶) 製造装置

単結晶・多結晶型太陽電池の全ライン(インライン・バッチ方式)の製造装置

特徴

- ・テクスチャリング……………バッチ・インライン装置
- ・拡散炉……………P塗布装置・チューブ(バッチ)式・インライン装置
- ・PSG(ISO)……………バッチ・インライン装置
- ・反射防止膜(AR)成膜……………PECVD装置
- ・配線印刷……………スクリーン印刷/乾燥炉
- ・配線形成(BSF形成)……………焼成炉
- ・その他関連装置





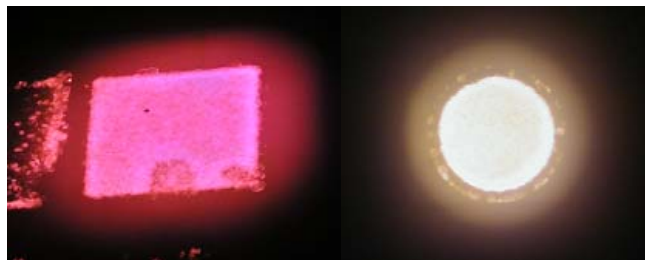
## 5-5 FEL事業製品

### ナノダイヤモンド薄膜製造

金属等の材料の表面に、ナノダイヤモンドの薄膜を生成したエミッターを製作。

#### 特徴

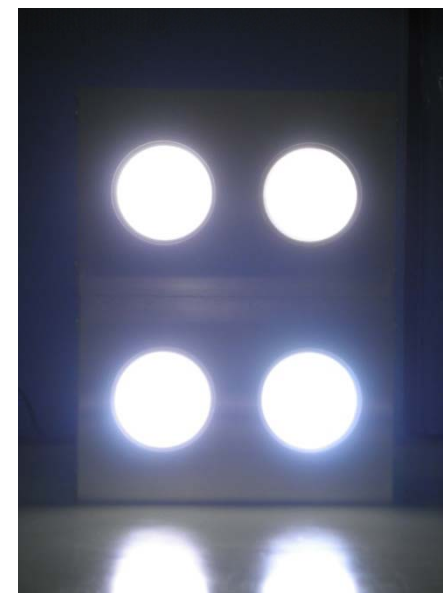
- ・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない。
- ・LED(発光ダイオード)に比べ発光効率が高く省エネ効果がある。
- ・蛍光灯に比べ長寿命である。
- ・蛍光灯、LEDに比べ発熱量が少ない。
- ・色合成の自由度が高い。



発光写真



試作品



試作品

# 5-6 精密熱処理関連製品(ワイエイシイデンコー)



<b>フラットパネルディスプレイ(FPT)用 加熱装置</b>	液晶用縦型多段式ガラス焼成炉、 液晶縦型多段式ガラスアニール炉 液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉
<b>太陽電池関連装置</b>	縦型ガラス基板加熱装置 薄膜太陽電池EVA架橋炉 ウォーキングビーム式連続乾燥炉 縦型多段式拡散炉
<b>電子部品加熱炉</b>	ローラーハース式連続アニール炉 マッフル型コンベア式連続焼成炉、マッフルレス型コンベア式連続焼成炉 電子部品用各種テスト炉
<b>ヒーター及び関連機器</b>	ラジアントパットヒーター (PD・GPD シリーズ) インフラ ユニ (BD・SG シリーズ) インフラ ユニット ヒーター (PS・PU・PH・PM シリーズ) <span style="float: right;">各種ヒーター</span>
<b>自動車部品用加熱装置</b>	鋼板加熱装置、金型加熱装置、金型予熱装置



TFT、配向膜焼成  
シール乾燥機



コンベア式連続焼成炉



ユニット ヒーター

## 5-7 クリーニング事業製品



<b>ボディープレス機</b>	シャツを前後から熱板ではさみ、シャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもちプレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリア付のタイプもあり。
<b>タック・スリーブプレス機</b>	シャツのタック部・袖部をプレスする装置。ダブルタイプとシングルタイプがある。
<b>カラー・カフスプレス機</b>	シャツの襟部・カフス部をプレスする装置。ダブルタイプとシングルタイプがある。
<b>自動包装機</b>	クリーニング完了後の衣類を自動で包装する装置。 ハンガーにかけたまま包装する立体タイプと、畳んだ状態で包装する平面タイプがある。
<b>アパレル関連機械</b>	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ。



ワイシャツ用ボディープレス機  
(ダブルタイプ)



全自動包装機 (立体タイプ)



ウール仕上機



人体型仕上機



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまやか先端技術企業

 **ワイエイシー株式会社**

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予数値と異なる可能性があります。